

國立高雄師範大學職業衛生風險評估表

系所：電子工程學系

實驗室名稱：505 半導體實驗室

填報日期：2014/01/06

實驗室作業流程概要內容：

(含實驗方法、程序、儀器設備機具、材料等)

先確定探針放置的防潮箱濕度正不正確，將探針裝置在量測載台上，開啟顯微鏡光圈電源，確認探針針頭有無損壞，再將載台旋鈕歸零，歸零

後將探針點在晶片的 drain, source, gate，下好探針後，關閉黑箱，關閉勿太大力以免針頭損壞，開啟 4155 電源，放入磁碟片讀取資料檔，

設定數據完開始量測，量測完，關閉 4155，將探針歸零後取出晶片，把探針從載台中取出，放回防潮箱中，確認防潮箱濕度

危害鑑別與風險評估表

附表	(附表一)										(附表二)				(附表三)
	(第1項)	(第2項)	(第3項)			(第4項)	(第5項)	(第6項)		風險評估				風險等級	
項次	區域/設備/作業	作業步驟	狀況			安全衛生危害因子說明	災害類型	現有風險控制方法		嚴重度 S	危害發生 機率 P	風險控制 成效 C	風險 R=S×P×C		風險等級
			例行	非 例行	緊急			軟體	硬體						
1.	半導體量測分析儀	量測晶片參數	√			操作不當等因素可能發生感電或漏電	感電或漏電	安全教育訓練	張貼警語或告知	4	3	0.6	7	D(暫時可接受但人需注意)	
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															

填表人員：

實驗場所負責人：

系所主管：